

8-1-1-2 ブリスタ／爆板 / Blister

【特徴】 微少な剥離が進行し、基板表面に膨らみが見られる状態の欠陥

【特征】 微細的剥離在进行、板面有鼓起状的缺陷。

【Characteristics】 As the small separation in a laminate gets bigger, the surface of the board becomes blistered.

【原因・判断ポイント・発生工程】 各層の界面に残された異物による密着強度不足により、熱ストレスに耐えられずに出来た微少な剥離が進行したもの（はんだ耐熱試験、熱衝撃試験、部品実装、エージング試験）

【原因、判断要点、发生工序】 各层的界面残留杂物，影响粘结强度，不能承受热应力而逐渐剥离所引起的（焊料耐热试验、热冲击试验、元件安装、老化试验）。

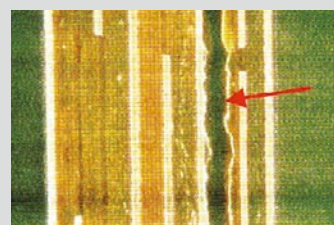
【Causes/processes involved/keys to judgment】 A foreign material left in the interface of the layers weakens adhesion and resistance to heat stress, causing the blister. The defect takes place as a result of the progress of a small separation. (Solder temperature resistance test, thermal shock test, component mounting and aging test)



【コメント】
顕微鏡倍率× 10

【注釋】
显微镜倍率 × 10

【Comments】
Magnification: ×10



【コメント】
断面状態
顕微鏡倍率× 30

【注釋】
截面状态
显微镜倍率 × 30

【Comments】
Microsection
Magnification: ×30

8-1-1-3 ミーズリング／白斑 / Measling

【特徴】 基材のガラスクロスと樹脂が、ガラスクロスの織り目の部分で剥離し、白っぽい点状に見える状態の欠陥

【特征】 基材的玻璃纤维和树脂在玻璃布的织纹分离，显示偏白点的缺陷。

【Characteristics】 Glass fibers and resin of the base material are separated at the intersection, which forms a white spot.

【原因・判断ポイント・発生工程】 吸湿状態の基板が、繰り返し熱ストレスを受けたり、強い熱ストレスを受けて出来たもの（はんだ耐熱試験、熱衝撃試験、エージング試験）

【原因、判断要点、发生工序】 吸湿的板件受到周期性应力，或者热应力的影响所引起的（焊料耐热试验、热冲击试验、元件安装、变质试验）。



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×